

2022 年 10 月 14 日

DEIM2023 産学連携委員会

委員長 清田陽司(LIFULL)

副委員長 西村和哉(NTT データ)

## DEIM2023 スポンサー募集

DEIM2023 のスポンサー企業・団体の募集をご案内いたします。本大会の成功と学術の振興のため、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM) は、データ工学と情報マネジメントに関する様々な研究テーマの討論・意見交換を目的としたワークショップです。ここ数年は新型コロナウイルスによる感染拡大の可能性を考慮し、完全オンライン形式で開催しておりますが、おかげさまで前回大会である DEIM2022 では、参加者数が過去最高の 1,376 名となり、幅広い分野のコンピュータ科学研究者が一堂に会する主要イベントへと成長しています。

DEIM2023 では、with コロナ時代の新たな試みとして「直列ハイブリッド形式」で開催いたします。一般発表 (1 日目～3 日目) をオンラインで、その後オフライン会場に集まり、4 日目と 5 日目はチュートリアルやポスター発表を中心としたネットワーキングイベントを行います。運営一同、オンラインの利点や対面開催の意味を何度も議論し、新しい研究会の形として提案し挑戦することといたしました。皆さまと共に新しい研究会の形を築き上げてまいります。

### <DEIM2023 開催概要>

#### 【名称】

第 15 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM2023)  
(第 21 回日本データベース学会年次大会)

#### 【主催】

日本データベース学会  
電子情報通信学会 データ工学研究専門委員会  
情報処理学会 データベースシステム研究会

#### 【Web ページ】

<https://event.dbsj.org/deim2023/>

#### 【開催期日】

2022 年 3 月 5 日 (日) ～3 月 9 日 (木)

#### 【開催形態】

直列ハイブリッド形式

3 月 5 日～7 日：オンライン開催

3 月 8 日～9 日：現地開催 (長良川国際会議場、岐阜県岐阜市長良福光 2695-2)

DEIM2023 の協賛プランは、「プラチナ」「ゴールド」「シルバー」の3つのプランを用意しております。また、日本データベース学会（DBSJ）の活動を常日頃からご支援いただいている DBSJ 維持会員各位には、協賛金の割引をいたします。特典の内容については、下記をご覧ください。本大会の成功と学術の振興のため、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

なお、お申し込み多数の場合には、一部の特典をご提供できない可能性がございます（先着順とさせていただきます）。上限数はプログラム編成や会場の制約、COVID-19 等感染症の情勢や必要な対策等に応じて変動する可能性がございます。また、COVID-19 等の感染拡大の状況によっては、現地での特典をご提供できない可能性もございます。あらかじめご了承くださいますと幸いです。お早めのお申し込みをお願い申し上げます。特典の詳細は、お申し込み後に改めてご案内いたします。

ご検討くださいますようお願い申し上げます。

## 1. 協賛プラン

	協賛特典※1	プラチナ 40 万円(税込)※2	ゴールド 20 万円(税込)※2	シルバー 5 万円(税込)※2
1	ロゴ掲載 (Web ページ・バーチャル背景)	大	中	小
2	会議ポータルへのコンテンツ掲載 (動画・テキスト・ハイパーリンクなど)	○	○	○
3	現地での常設ブース等の設置 ※3	○	○	---
4	技術報告への登壇※4	1 枠	1 枠	---
5	スポンサー賞の授与	○	---	---
6	現地ランチョンセミナーの開催権（限定 1 枠）※5	○	---	---

※1 DEIM2023 への参加費は別途お支払いをお願いいたします。

※2 DBSJ 維持会員には、協賛金の割引(20%)をご提供いたします。是非この機会にご入会をご検討ください (DBSJ 維持会員について <https://dbsj.org/overview/sponsor/>)。

※3 会場都合により特典の上限数に達した場合は先着順とさせていただきます。なお、設置場所についてはプラチナプランのスポンサー様を優遇いたします。

※4 プログラム編成の都合により特典の上限数に達した場合は先着順とさせていただきます。

※5 開催権の行使にあたり、20 万円（税込み、DBSJ 維持会員の割引対象外）を別途申し受けます。また、会場および弁当の手配費用を別途ご負担いただきます。

### 1.1. 募集要項

ご協賛いただくスポンサー様は、DBSJ/DEIM で対象とするデータ工学および情報マネジメントに関わる技術をサービスや製品の開発にご活用されている、もしくはこれら分野の研究に取り組まれていることを原則といたします。

## 1.2. 協賛プランのポイント

DEIM2023 では、4 年ぶりの現地開催の機会を最大限に生かし、現地でより多くの露出機会を持っていただくことに注力いたします。また、例年好評をいただいている「技術報告への登壇」はオンラインでの開催とし、より多くの参加者に聴講されるようにいたします。万が一、COVID-19 等の感染拡大の状況により、現地での露出機会をご提供できない場合には、次回（DEIM2024）の協賛金割引など、ご協賛いただくスポンサー様に十分なメリットをご提供できるように配慮いたします。

### 多くの露出機会

すべてのプランで「スポンサーロゴの掲載」「会議ポータルへのコンテンツ掲載」、ゴールドプラン以上で「技術報告への登壇」「現地での常設ブースの設置」、プラチナプランで「スポンサー賞の授与」「ランチョンセミナーの開催権」をご利用可能となります。参加者への露出機会の増加に是非ご活用ください。

### テクノロジーショーケースとしての技術報告

技術報告は、各社の先駆的な取り組みの紹介や技術力のアピールなど、各社のテクノロジーショーケースとしてご好評いただいております。

### スポンサー賞授与を通じた学生による優れた研究活動の奨励

DEIM2022 でご好評いただいたスポンサー賞を、引き続き設定いたします。スポンサー様のそれぞれの視点で選考していただくスポンサー賞は、学生の研究活動に大きな励みとなることが期待されます。是非、スポンサー様それぞれのオリジナリティあふれる副賞とともに、学生による優れた研究活動をご奨励ください。スポンサー賞はプラチナプランでご利用可能です。

### 学会現地会場における導線への配慮・オンライン会議ポータル（Zoom Events）での露出

DEIM2023 では、学会の会場において多くの参加者が通る場所に常設ブースを設置し、より多くの参加者との交流の機会をもっといただけるように配慮いたします。現地での常設ブース設置はゴールドプラン以上でご利用可能です。また、今回採用するオンライン会議ポータル（Zoom Events）に、動画やテキストコンテンツを掲示していただくことで、現地での露出機会をより効果的なものにするとともに、より多くの参加者にオンライン上でアピールしていただけます。

### スポンサー企業・団体間でのノウハウやプラクティスの共有

産学連携の強化のため、スポンサー賞など新しい試みに挑戦しております。ハイブリッド形式、オンライン形式の学会参加、協賛に不慣れなスポンサー様や、新たに DEIM への協賛をご検討くださっているスポンサー様にも協賛特典を有効活用していただくべく、スポンサー間でノウハウやプラクティスを共有する場を、DEIM2022 に引き続き設けます。スポンサー間のつながりやコミュニティ作りの一助となれば幸いです。

## 2. 特典について

### 2.1. ロゴ掲載

DEIM2023 の Web ページと、オンラインミーティング用のバーチャル背景画像にロゴ

を掲載します。

DEIM2023 の Web ページには、ご希望のリンク先へのリンクを張ったロゴを掲載します。ロゴの大きさは協賛プランによって異なります。同じ協賛プラン内では、ランダムな順番で表示します。

(ご参考) DEIM2022 のロゴ掲載：<https://event.dbsj.org/deim2022/>

バーチャル背景画像は、実行委員等がオンラインミーティング時にバーチャル背景として利用します。バーチャル背景へのロゴ掲載順は、同じ協賛プランの種別毎にお申し込み順とします。

(ご参考) DEIM 2022 で配布した背景画像

<https://github.com/DEIM-Management-System/Artwork/blob/main/deim2022/README.md>

ロゴのご提出方法については、お申し込み後にご連絡させていただきます。

## 2.2. 会議ポータルへのコンテンツ掲載

DEIM2023 の全参加者がログインする会議ポータル (Zoom Events) に、各種オンラインコンテンツ (動画、テキスト、ハイパーリンクなど) を掲載いただけます。常設ブースや技術報告などの内容の事前ご案内、スポンサー様の技術力アピールなどに、ぜひご活用ください。

(ご参考) Zoom Events についての解説動画 (Zoom 社 YouTube チャンネル)

[https://www.youtube.com/watch?v=HffLPvDZ4O0&cc\\_lang\\_pref=ja](https://www.youtube.com/watch?v=HffLPvDZ4O0&cc_lang_pref=ja)

## 2.3. 常設ブースの設置 (現地会場)

DEIM2023 の現地会場に、常設ブースを設置いたします。本特典は「プラチナ」「ゴールド」プランのみに提供します。

「プラチナ」プランのスポンサー様に「ゴールド」プランのスポンサー様よりも目立つ場所にスペースを提供したいと考えております。また、可能な限り多くのスポンサー様にブースを設置いただけるよう検討してまいります。ただし、ブース設置のお申し込み多数の場合は、上位スポンサー様優先および先着順とし、上限に達した場合にはお申し込みを打ち切る場合がございます。スポンサー数、会場や感染症対策の制約によって、スペース提供の形態に若干の変更が生じる可能性もございますことをご承知おきください。

なお、COVID-19 等感染症の状況に応じて、完全オンライン開催へと変更となった場合には、会議ポータル内でのコンテンツ掲載のみとなります。このとき、掲載コンテンツへの参加者の誘導ならびに盛り上げ施策を追加で検討いたします。

現地会場に設置するブースのサイズ・設営方法については、後日ご連絡いたします。

## 2.4. 技術報告への登壇

DEIM2023 のセッション内でスポンサー様の先駆的な取り組みの紹介や技術力のアピール等を実施いただける技術報告への登壇の権利を「プラチナ」「ゴールド」プランに提供

します。

技術報告でご発表いただく内容は、スポンサー様独自の技術的なコンテンツに限ります。学術会議である DEIM2023 のセッション内でご発表いただくという観点からのご配慮願います。

発表時間は、DEIM2023 の論文発表に準じます。ご発表の題目とご発表者のお名前を、論文発表と同様にプログラムに掲載します。ご発表のセッションは、ご希望をお伺いした上で検討しますが、ご希望に添えない場合もございますことをご承知おきください。

なお、技術報告にご登壇いただく方にも、DEIM2023 への参加登録を別途お願いしております。技術報告でのご発表だけでなく、セッションへの参加や参加者との交流を通して、DEIM2023 を盛り上げていただければ幸いです。

## 2.5. スポンサー賞の授与

スポンサー様独自のご見識に基づいて、学生の研究活動を奨励していただくことを目的とした、スポンサー賞の授与権を提供します。本特典は「プラチナ」プランにのみ提供します。

スポンサー賞の選定対象は、DEIM2023 で発表された学生を筆頭著者とする研究発表です。スポンサー様ごとに、授与の候補となる発表をいくつか選定していただきます。最終的な授与対象は、多くの学生の発表を奨励する観点から、産学連携委員とスポンサー賞の授与を希望するスポンサー様とを含むメンバーで協議の上で決定いたします。選定の方法や協議の方法については DEIM2023 開催までにご連絡いたします。

また、副賞の授与をしていただくことも可能です。副賞は各スポンサー様でご用意ください。なお、受賞者間の公平性という観点から、市価 10 万円（税別）を超えるような高価な副賞はご遠慮いただくようお願いいたします。

ご参考までに、過去に受賞した学生から喜ばれた副賞の事例を以下に示します。

- **今後の研究に活用できるもの**  
ディープラーニングの研究をしている学生などを念頭に、GPGPU カードなどを贈呈
- **研究室の全員で楽しんでもいただけるデバイス**  
研究室の飲み会や旅行などで活用していただけるデバイス（360° カメラなど）を贈呈
- **強いメッセージ性のある副賞**  
「研究を頑張ってほしい」という意味を込めて、「エナジードリンク 1 年分」などの賞品を贈呈
- **入手の心理的ハードルが高いデバイス**  
Kickstarter でしか買えない VR 系デバイスやドローンなどを贈呈
- **特別な機会の提供**  
賞品ではなく、オフィス見学へのご招待やキーパーソンの方とのお食事など、学生が普段なかなか得られない機会を副賞として提供

## 2.6. ランチョンセミナーの開催権

スポンサー独自のランチョンセミナーを開催する権利を先着 1 社・団体様にご提供しま

す（申し込み期限：2022 年 11 月 30 日（水））。本特典は「プラチナ」プランにのみ提供します。

ランチョンセミナーでは、スポンサー様独自のイベントや講演を開催していただくことができます。技術報告とは異なり、技術的なコンテンツに限定をいたしません。

（ご参考）前回大会のスポンサーイベント

<https://cms.dbsj.org/deim2022/program/?sponsor>

開催する時間帯は、5 日目（最終日）のお昼を予定しております。詳細な開催の時間帯や開催方式については、COVID-19 等感染症の状況を鑑みて、後日ご連絡させていただきます。

### 3. お申し込み方法

お申し込みは、別紙「DEIM2023 ご協賛お申し込みフォーム」にご記入の上、下記連絡先までメールでお申し込みください。

申し込みの受付は、【2022 年 11 月 1 日 正午】に開始いたします。

連絡先：< [deim2023-kyousan@googlegroups.com](mailto:deim2023-kyousan@googlegroups.com) >

協賛金のお支払い方法については、後日、ご担当者様にご連絡いたします。

### 4. 問合せ先

ご不明点やご質問などございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

連絡先：< [deim2023-kyousan@googlegroups.com](mailto:deim2023-kyousan@googlegroups.com) >

なお、DEIM2023 のスポンサー様を含む、企業間の交流（ノウハウやプラクティスの共有）を目的とした Slack を試験的に開設しております。お申し込みいただいたスポンサー様のご担当者様または関係者様をご招待させていただきます。

以上

## 資料

### 前回大会(DEIM2022)スポンサー企業

#### ■ プラチナスポンサー

ウォンテッドリー株式会社

LINE 株式会社

株式会社リクルート

株式会社 LIFULL

株式会社 LegalForce

日本電気株式会社

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

MEGAZONE 株式会社

#### ■ ゴールドスポンサー

ヤフー株式会社

楽天グループ株式会社

PingCAP 株式会社

エムスリー株式会社

株式会社 Gunosy

Sansan 株式会社

株式会社東芝

富士通株式会社

株式会社 NTT データ

株式会社エクサウィザーズ

株式会社日立製作所

#### ■ シルバースポンサー

株式会社エスペラントシステム

株式会社リーバー